



深圳市锦辉宏业电子有限公司  
SHENZHEN JHHY CIRCUIT CO., LTD

### 工艺能力参数表

项目	加工能力	工艺详解
层数	1~10层	层数，是指PCB中的电气层数（敷铜层数）。
板材类型	FR-4板材,铝基板	板材类型：纸板、半玻纤、全玻纤（FR-4）、铝基板。
最大尺寸	40cm * 50cm	锦辉开料裁剪的工作板尺寸为40cm * 50cm，通常允许客户的PCB设计尺寸在38cm * 38cm以内，具体以文件审核为准。
外形尺寸精度	±0.2mm/±0.5mm	锣板外形公差±0.2mm，V-cut外形公差±0.5mm
板厚范围	0.4~2.0mm	锦辉目前生产板厚：0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0mm.
板厚公差（T≥1.0mm）	± 10%	比如板厚T=1.6mm，实物板厚为1.44mm（T - 1.6×10%）~1.76mm（T + 1.6×10%）。
板厚公差（T < 1.0mm）	±0.1mm	比如板厚T=0.8mm，实物板厚为0.7mm（T-0.1）~0.9mm（T+0.1）。
最小线宽	4mil	线宽尽可能大于6mil，最小不得小于4mil.
最小间隙	4mil	间隙尽可能大于6mil，最小不得小于4mil.
成品外层铜厚	1oz~2oz（35um~70um）	默认常规电路板外层铜箔线路厚度为1oz，可做2oz（需下单备注说明）。
成品内层铜厚	1oz/1.5oz(35um/50um)	默认常规电路板外层铜箔线路厚度为0.5oz, 可做2oz（需下单备注说明）。
钻孔孔径（机械钻）	0.3~6.3mm	最小孔径0.3mm，最大孔径6.3mm，如果大于6.3mm工厂要另行处理。机械钻头规格为0.05mm为一阶，如0.3mm，0.35mm，0.4mm...。
过孔单边焊环	0.15mm(6mil)	如导电孔或插件孔单边焊环过小，但该处有足够大的空间时则不限制焊环单边的大小；如该处没有足够大的空间且有密集走线，则最小单边焊环不得小于6mil。
孔径公差（机器钻）	±0.08mm	钻孔的公差为±0.08mm，例如设计为0.6mm的孔，实物板的成品孔径在0.52--0.68mm是合格允许的。
阻焊类型	感光油墨	感光油墨是现在用得最多的类型，热固油一般用在低档的单人纸板

最小字符宽	0.15mm(6mil)	字符最小的宽度，如果小于6mil，实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰
走线和焊盘距板边距离	≥0.3mm	锣板出货，线路层走线距板子外形线的距离不小于0.3mm；V割拼板出货，走线距V割中心线距离不能小于0.4mm.
走线与外形间距	≥6mil	如导电孔或插件孔单边焊环过小，但该处有足够大的空间时则不限制焊环单边的大小；如该处没有足够大的空间且有密集走线，则最小单边焊环不得小于6mil.
拼板：无间隙拼板	0mm间隙拼板	板子与板子的间隙为0mm.
拼板：有间隙拼板	2.0mm间隙拼板	有间隙拼板的间隙不要小于2.0mm，否则锣边时比较困难.
PADS厂家铺铜方式	Hatch方式铺铜	厂家是采用还原铺铜（Hatch），PADS软件设计的客户请务必注意.
Pads软件中画槽	用Outline线	如果板上的非金属化槽比较多，请用outline画。
Protel/dxp软件中开窗层	Solder层	少数工程师误放到paste层，锦辉对paste层是不做处理的.
Protel/AD外形层	用Keepout层或机械层	请注意：一个文件只允许一个外形层存在，绝不允许有两个外形层同时存在，请将不用的外形层删除，即：画外形时Keepout层或机械层两者只能选其一。如右图
半孔工艺最小孔径	0.6mm	半孔工艺是一种特殊工艺，最小孔径不得小于0.6mm。
阻焊层开窗	0.1mm	阻焊即平时常说的说绿油，锦辉目前暂时不做阻焊桥。